

EC360 DIAMOND

Wärmeleitpaste Serie

Die EC360® DIAMOND Serie steht für High Performance. Hightech Nano-Graphen Partikel, eingebettet in einer Basis aus feinen Aluminium- und Magnesium-Partikeln, ermöglichen eine herausragend hohe Wärmeleitfähigkeit von 11W/mK. Entwickelt mit einem Fokus auf hohe Performance ist sie die perfekte Wahl für die Kühlung von GPUs und CPUs in extremen Kühlungs-Szenarien, wie Overclocking. Kurzum,

sorgt sie für eine maximal-effiziente Wärmeableitung in jedem Anwendungsfall. Gleichzeitig ist die Wärmeleitpaste sicher anzuwenden, sie ist nicht elektrisch leitfähig, einfach zu verteilen und lange haltbar. Eine niedrige Bleed-Konstante und gute Verdunstungs-Eigenschaften machen sie langlebig und sorgen dafür, dass sie nicht austrocknet.

Material Zusammensetzung

Typ	Prozentsatz
Aluminiumoxid	40%
Silikon	37%
Magnesiumoxid	20%
Graphen	3%

Typen und Konfigurationen

Typ*	Verfügbare Größen*
Tube	1 g, 20 g

* Andere Konfigurationen und Größen sind auf Wunsch möglich, für gewerbliche Anfragen kontaktieren Sie uns gerne unter: sales@extremecool360.de

Technische Spezifikationen

Eigenschaft	Einheit	Wert	Testmethode
Farbe	-	grau	Visuell
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	11,0	ASTM D5470
Thermischer Widerstand	°C-in2/W	0,0013	ASTM D5470
Relative Dichte	g / cm ³	3,2	ASTM D 792
Evaporation(150°C / 24 Std)	%	0,15	FED STD 791
Spezifischer Volumenwiderstand	Ohm-cm	3,0 x10 ¹³	ASTM D 257
Viskosität	cP	15000	-
Dielektrizitätskonstante	1Mhz	3,0	ASTM D 150
Betriebstemperatur	°C	-30 - 240	EN 344

Installationsempfehlung

- Oberflächen von Fett und anderen Verunreinigungen befreien, wir empfehlen die Säuberung mit 90% Isopropylalkohol.
- Dann einen runden Tropfen Wärmeleitpaste mittig auf den Chip (z.B. einen CPU oder GPU) auftragen
- Dann den Kühler installieren. Idealerweise sollte sich der Tropfen nun, ohne Luftblasen, über die gesamte Fläche verteilt haben.
- Sollte das Resultat nicht zufriedenstellend sein, die vorigen Schritte wiederholen bis das gewünschte Ergebnis erreicht wurde.